

TOWA (コード 6315)

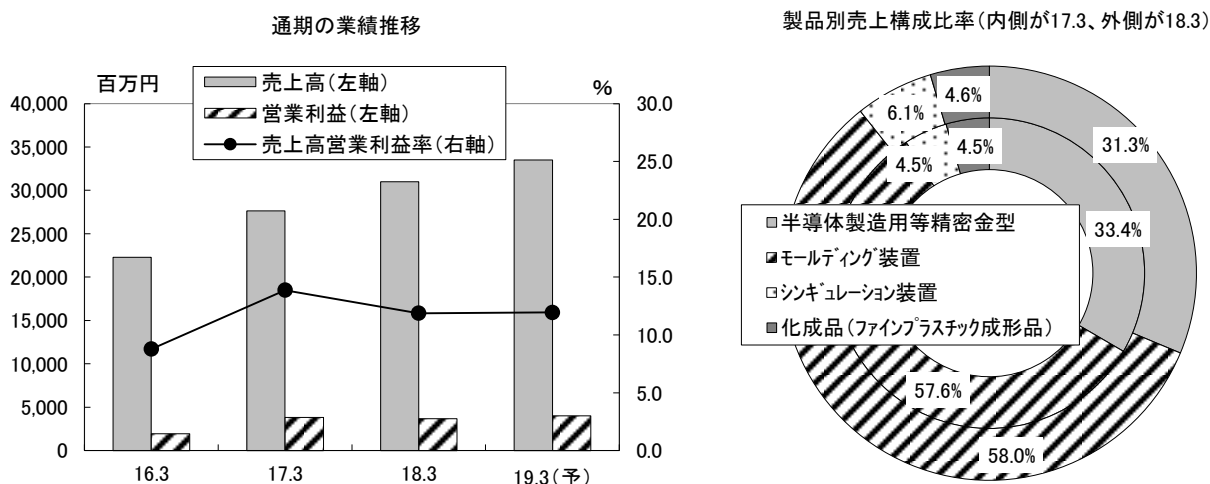
◆通期業績推移(連結) (19.3 予は会社側予想)

決算期	売上高	営業利益	1株純利益	1株配	営業CF	投資CF	財務CF	現金及び現金同等物
16.3	22,270	1,954	73.0	10.0	3,254	▲1,806	▲868	6,027
17.3	27,632	3,831	154.6	16.0	2,054	▲1,194	▲1,020	5,757
18.3	31,010	3,682	121.0	16.0	2,923	▲1,699	▲843	6,146
19.3予	33,500	4,000	116.0	16.0	—	—	—	—

◆各決算期の第2四半期業績推移(連結) (19.3 予は会社側予想)

決算期	売上高	営業利益	1株純利益	1株配	営業CF	投資CF	財務CF	現金及び現金同等物
16.3	11,678	1,270	51.4	0.0	1,415	▲321	▲1,212	5,350
17.3	14,154	1,968	64.3	0.0	▲528	▲787	739	5,266
18.3	15,605	2,491	66.3	0.0	1,473	▲579	▲816	5,871
19.3予	16,700	2,000	58.0	0.0	—	—	—	—

(CF=キャッシュ・フロー。現金及び現金同等物は各期末値。▲はマイナス。単位は百万円、円)



特色…半導体製造プロセスの後工程で行われる樹脂封止 (モルディング) 装置のトップメーカーで、モルディングされた製品を個片化し収納するシンギュレーション装置や、モルディング装置などを搭載する精密金型、化成品 (ファインプラスチック成形品) なども製作。売上のほぼ 9 割が海外顧客というグローバル企業。連結売上高のうち半導体製造装置が 9 割以上を占め、それらの装置で使われる精密金型が約 3 割、リードフレーム上の半導体チップを外部環境から守るため金型を使ってモルディングする半導体樹脂封止装置が約 6 割となっている。

モルディングとは、パソコン、スマートフォン、デジカメ等に使われている半導体チップや金線を、外部からの衝撃・温度・湿度から守るために樹脂で覆い固める技術のこと。同社は、1979 年 4 月に「東和精密工業」として創業され、80 年 2 月には、半導体モルディング工程の自動化、省資源化、高品質化、高生産性を実現した「マルチプランジャ成形方式」による全自動の半導体樹脂封止装置の試作に成功。88 年 12 月に「TOWA」に社名変更し、現在に至っている。従来より半導体など電子部品の樹脂封止に用いられてきた「トランスファ方式」(金型の凹部にあたる「キャビティ」という部分にゲート(供給口)から流動性樹脂を射出して硬化させる方法)に加え、同社開発の「コンプレッション方式」(あらかじめ供給された流動性樹脂に半導体チッ

プを漬けた後、その樹脂を硬化させる方法)では、トランスファ方式におけるゲートやランナなどが不要になり、樹脂の使用効率がほぼ100%で材料の効率化や廃棄物の低減を実現するなど、同社のモールディング技術は世界トップクラスを誇っている。

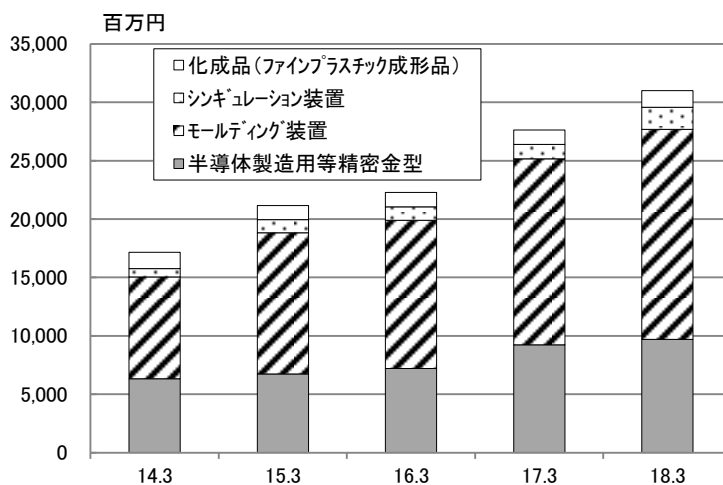
また、高品質で廃棄樹脂ゼロのLEDレンズを成形する装置を開発しており、照明用途以外にも、液晶のバックライト、信号機や自動車のランプ類にも拡大しているLED市場に進出。さらには、高性能、省エネルギーを実現する自動車が求められる時代の流れに乗って、カーエレクトロニクス分野のモールディング装置を開発。例として、ECU(エンジンコントロールユニット)は、これまで金属のケースに入れて保護していたものを、同社のモールディング技術を使って樹脂封止することで、信頼性やコストダウンにも大きく寄与している。

同社の事業セグメントは「半導体製造装置事業」「化成品(ファインプラスチック成形品)事業」の2つで構成され、18年3月期実績での売上構成比率(連結ベース)は、半導体製造装置事業95.4%、化成品事業4.6%となっている。さらに、半導体製造装置事業は製品別では「半導体製造用等精密金型」(売上構成比率31.3%)、「モールディング装置」(同58.0%)、「シンギュレーション装置」(同6.1%)で構成されている。地域別売上高(18年3月期)については、国内10.1%、台湾22.2%、韓国12.1%、中国31.6%、その他アジア20.1%、欧米3.9%で、売上高全体の89.9%が海外で占められている。

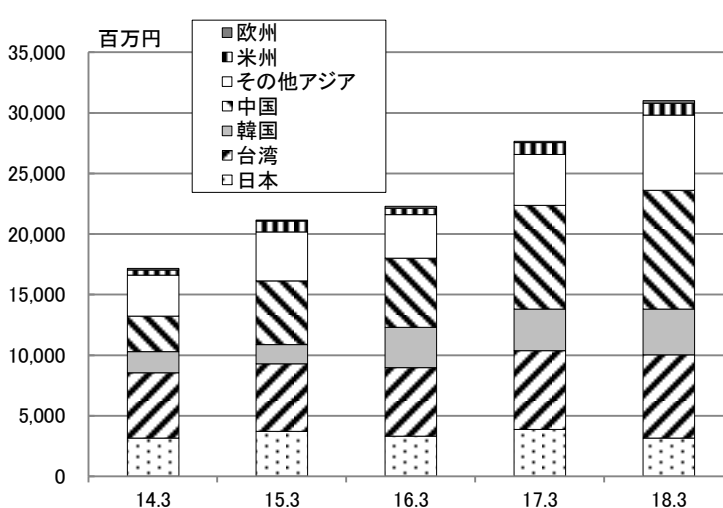
18年3月期の業績概況…18年3月期の業績は、売上高310億1,000万円(17年3月期比12.2%増)、営業利益36億8,200万円(同3.9%減)、経常利益35億4,000万円(同14.3%減)、当期純利益30億2,600万円(同21.7%減)となった。製品別では主力のモールディング装置が、地域別では中国やその他アジアが大きく伸ばしたことから、売上高は2ケタの伸び率となった。利益面では、生産性の効率化によって原価低減を図ったものの、コンプレッション装置の下期における比率低下や、シンギュレーション装置の売上増による利益率の低下など、製品ミックスの要因に加え、受注・売上高の増加や短納期対応による外注協力会社への費用増も加わり、減益になった。1株当たりの年間配当金は、17年3月期実績と同じく16円となっている。

セグメント別の売上高は、半導体製造装置事業が295億7,900万円(同12.1%増)、化成品事業が14億3,100万円(同14.5%増)。半導体製造装置事業の製品別の内訳は、半導体製造用等精密金型が96億9,100万円(同5.1%増)、モールディング装置が179億8,100万円(同12.9%増)、シンギュレーション装置が19億500万円(同54.3%増)となった。セグメント別の営業利益では、半導体製造装置事業が35億200万円(同5.3%減)、化成品事業が1億8,000万円(同35.1%増)となっている。

通期の製品別売上高推移



通期の地域別売上高推移



地域別売上高（仕向地ベース）では、日本が 31 億 3,900 万円（同 18.5%減）、米州が 9 億 8,200 万円（同 0.7%減）に減少した一方、中国が 97 億 9,100 万円（同 14.4%増）、台湾が 68 億 8,900 万円（同 5.8%増）、その他アジアが 62 億 600 万円（同 47.7%増）、韓国が 37 億 7,100 万円（同 9.9%増）、欧州が 2 億 3,000 万円（同 177.1%増）にそれぞれ拡大した。

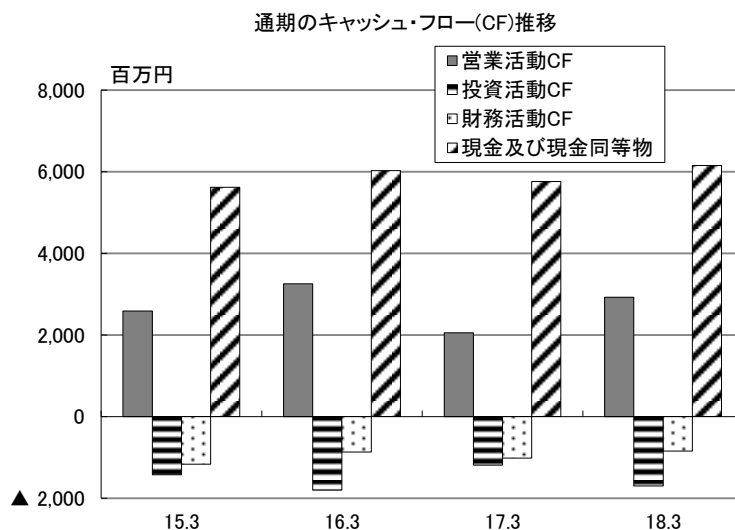
一方、利益面では、売上高の増加によるプラス要因（18 億 5,200 万円）を、受注増および短納期対応のための社外支出増（8 億 600 万円）、製品ミックス等（8 億 7,600 万円）、内製化対応や営業体制強化に伴う人件費増（4 億 9,700 万円）などのマイナス要因が打ち消す形で、営業利益は減少。営業外収益・費用では前年の為替差益（1 億 8,900 万円）に対し当期には為替差損（2 億 6,200 万円）を計上したことも加わり、経常利益、当期純利益は減益率が大きくなった。

キャッシュ・フロー（以下、CF）の状況については、18 年 3 月期末の現金及び現金同等物残高は 61 億 4,600 万円（17 年 3 月期末比 6.8%増）となった。営業活動CFは、税金等調整前当期純利益が 36 億円（17 年 3 月期比 13.0%減）、売上債権の減少額が 4,600 万円（17 年 3 月期は増加額 31 億 4,100 万円）たな卸資産の増加額が 21 億 700 万円（17 年 3 月期比 115.0%増）、仕入債務の増加額が 9 億 5,800 万円（同 2.1%減）、法人税等の支払額が 8 億 2,300 万円（同 61.1%増）となったことなどから、29 億 2,300 万円の収入（同 42.3%増）に増加した。投資活動CFは、有形及び無形固定資産の取得による支出が

15 億 900 万円（同 4.0%減）、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が 6,800 万円（17 年 3 月期は無し）となったほか、17 年 3 月期に 2 億 5,600 万円計上された関係会社株式の売却による収入が当期は無かったことなどから、16 億 9,900 万円の支出（17 年 3 月期比 42.3%増）に。財務活動CFは、長短借入金の借入れ及び返済による差引支出額が 3 億 8,500 万円（同 41.2%減）、社債の償還による支出が 4,000 万円（同 60.0%減）、配当金の支払額が 4 億円（同 60.0%増）になったことなどから、8 億 4,300 万円の支出（同 17.4%減）となった。

19 年 3 月期の業績見通し…19 年 3 月期の通期業績については、売上高 335 億円（前期比 8.0%増）、営業利益 40 億円（同 8.6%増）、経常利益 40 億円（同 13.0%増）、当期純利益 29 億円（同 4.2%減）の見通し。1 株当たりの年間配当金は 16 円の予定。

セグメント別売上高予想は、半導体製造装置事業が 319 億 5,000 万円（同 8.0%増）、化成部品事業が 15 億 5,000 万円（同 8.2%増）で、半導体製造装置事業のうち新事業は 55 億 5,000 万円（同 29.0%増）に伸びる見込み。地域別売上高は、前期比（小数点以下四捨五入）で日本 18%増、台湾 8%増、韓国 29%増、中国 15%増、その他アジア 22%減、欧米 13%増となっている。



本レポートは、会社側が発表した決算短信や決算説明資料などに基づき作成しており、証券投資の参考となる情報の提供を目的としたもので、証券の売買を勧誘する目的で作成したものではありません。株式の売買取引には、約定代金に対して手数料が必要となります。また、株式は、株価の変動により損失が生じる恐れがあります。投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなさいますようお願い致します。本レポートは各種データに基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありませんので、予めご了承下さい。なお、本レポートの著作権は西村証券に帰属しており、電子的・機械的などの方法を問わず、無断で本レポートを引用または複製、転送することを禁じます。